

WF6317

WF6317

良好なはんだ濡れ性が、ボイドフリーを実現

Excellent solder wettability delivers void-free results

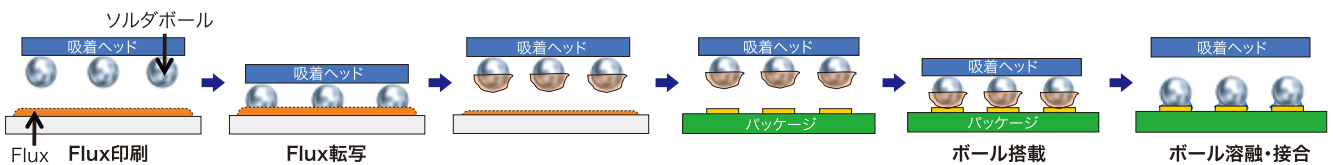
特長

- 安定したボール保持力と良好なはんだ濡れ性を有する
- 250℃リフローに対応した、洗浄容易な水溶性フラックス
- 低揮発性フラックスの採用で、リフロー炉の汚染を防止抑制

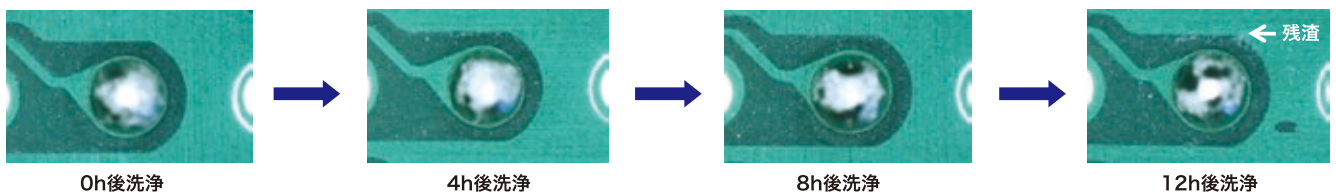


仕様

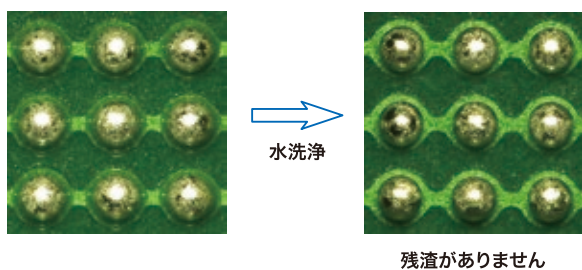
- 良好なスキージング性とボール保持力で、ソルダボールを実装



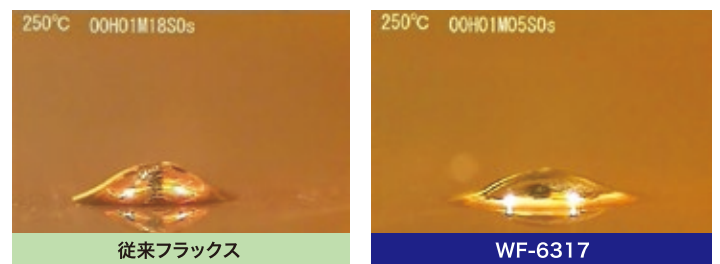
- 実装後8時間以内であれば、水洗浄でもフラックス残渣を除去



- 40℃の温水洗浄でフラックス残渣ゼロ



- Cu-OSP基板でも良好な濡れ性を有す



- 低揮発性フラックスの採用で、リフロー炉の汚染を抑制

